

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2020-049

杭州士兰微电子股份有限公司

关于增设募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2005号），公司向6名特定对象非公开发行了人民币普通股64,893,614股，每股发行价为11.28元，募集资金总额为人民币731,999,965.92元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币26,405,660.37元，实际募集资金净额为人民币705,594,305.55元。该项募集资金已于2018年1月3日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2018〕1号《验资报告》。

公司于2019年11月8日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议以及2019年11月25日召开的2019年第二次临时股东大会均审议通过了《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，该事项及表决结果详见公司分别于2019年11月9日及2019年11月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《关于调整募集资金投资项目相关事项的公告》（公告编号：临2019-046）和《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-049）。调整后的公司募集资金投资项目、投资金额、实施单位及募集资金专户开立情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目名称	募集资金投资金额	项目承担单位	募集资金专户开立情况
一、年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	30,559.43	-	-
其中：MEMS传感器芯片制造扩产项目	10,568.43	杭州士兰集成电路有限公司	已开立
MEMS传感器封装项目	10,000.00	成都士兰半导体制造有限公司	已开立
MEMS传感器测试能力提升项目	9,991.00	杭州士兰微电子股份有限公司	已开立
二、8吋芯片生产线二期项目	30,000.00	杭州士兰集昕微电子有限公司	已开立
三、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	10,000.00	成都集佳科技有限公司	尚未开立
合计	70,559.43	-	-

二、本次增设募集资金专户的情况

调整后的募集资金投资项目之“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”的实施主体为公司全资孙公司成都集佳科技有限公司（以下简称“集佳科技”）。为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，集佳科技拟在中国农业银行股份有限公司金堂县支行增设募集资金专项账户对募集资金进行监管。

公司于 2020 年 8 月 14 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了本次增设募集资金专户的事项，同时董事会授权公司董事长陈向东先生、集佳科技执行董事范伟宏先生办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。待各方签署募集资金监管协议后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 15 日